

瑞芯微电子股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”）的生产经营及业务发展需要，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海三星”）之间的采购或产品购销业务而形成的一系列债权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，公司董事会授权董事长励民先生与相关方签订担保协议等有关文件。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《瑞芯微电子股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。

二、担保情况进展

近日，公司与上海三星签订了《最高额保证合同》，为上海翰迈与上海三星自2023年12月6日至2028年8月10日期间的采购或产品购销业务而形成的一系列债权提供最高额度为1,400万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

三、担保协议的主要内容

保证人：瑞芯微电子股份有限公司

债权人：上海三星半导体有限公司

被担保人：上海翰迈电子科技有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：自债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间均单独计算。

担保额度：最高额度为1,400万美元

保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费等）。

是否有提供反担保：否

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年1月5日